



# W-GM-6200

## Wafer Edge Grinding Machine

- ウェーハサイズΦ 450mm
- ベストセラー機 W-GM シリーズ
- コンパクトな設計でスペース効率アップ
- X 軸・Y 軸・ $\theta$  軸の同期補完制御による高精度な研削
- タッチパネルによる簡単操作



株式会社 東精エンジニアリング

## W-GM-6200 仕様

基本仕様		
ウェーハサイズ	φ 450mm	
ウェーハの厚み	0.6 ~ 1.3mm (標準)	
ウェーハの形状	ノッチ	
研削部	2 ステージ	
外周加工用砥石形状	砥石溝径	φ 200mm
	砥石外径	φ 202mm
	内径	φ 30mm
	フランジ厚み	20mm
外周加工用砥石周速 (φ 202)	2500m/min (最大)	
研削スピード	外周部、オリフラ部、ノッチ部で個別に設定可能	
外周加工用スピンドル	ビルトインモータ方式	
操作パネル	15" カラー LCD タッチパネル	
シグナルタワー	3色表示灯	
装置寸法	4250 (W) x 2900 (D) x 2600 (H) mm	
装置重量	約 9000kg	
機構部仕様		
研削テーブル X, Y, Z 軸	分解能	1 μm
研削テーブル θ 軸	分解能	0.001°
	駆動方式	DD モータ
トランスファ部	搬送方式	吸着搬送 (上面)
洗浄部	洗浄方式	スピン洗浄
	乾燥方式	ドライエアー
供給部・収納部	方式	カセットキャリア
	カセット数	4 カセット (標準)
測定部仕様		
ウェーハ厚さ測定	分解能	1 μm
	繰り返し測定精度	± 2 μm 以内
	測定方法	非接触式
非接触式 アライメント機構	方式	グリーンLED 方式
	分解能	1 μm
	センタリング精度	± 35 μm 以内

## 株式会社 東精エンジニアリング

### 東精エンジニアリング

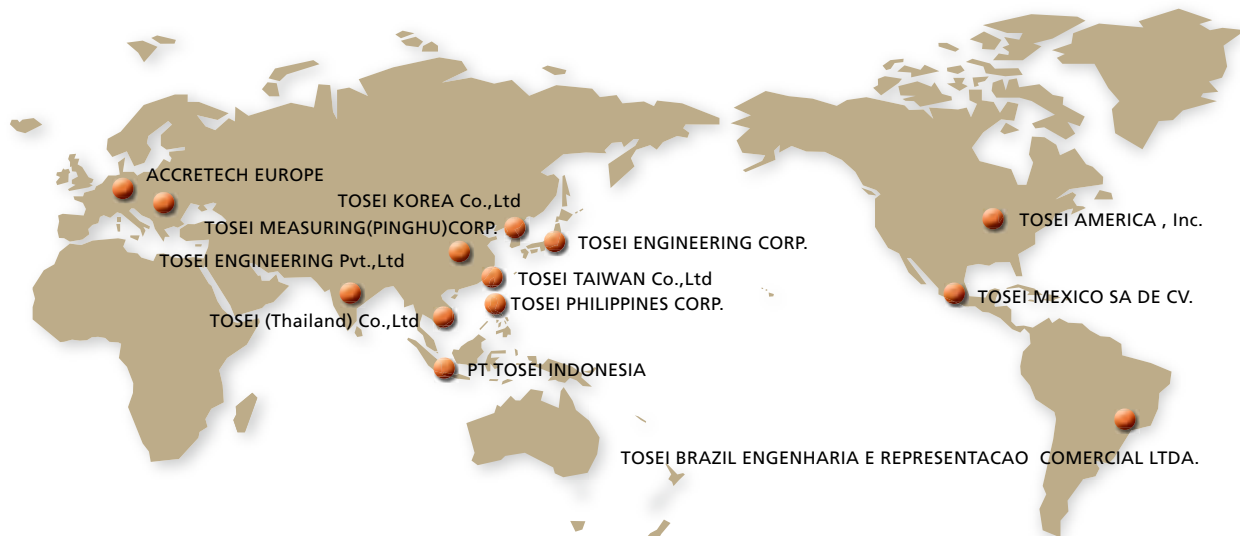
(本社)

〒300-0006 茨城県土浦市東中貫町 4-6  
TEL.029-830-1888 FAX.029-830-1881

(土浦工場 専用機事業部)

〒300-0015 茨城県土浦市北神立町 2-14  
TEL.029-830-1882 FAX.029-832-5742

### 海外拠点 OVERSEAS NETWORK



URL <http://www.toseieng.co.jp/>